

TECHNICKÝ LIST

Měkká pájka:

Slitina: **S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7**
Norma: ČSN EN ISO 9453 slitina č. 713

Základní charakteristika:

Eutektická bezolovnatá slitina používaná zejména v elektronice a elektrotechnice kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost. Lze použít pro pájení vlnou, selektivní pájení a pájení máčením. Má nejnižší teplotu tání ze všech slitin SnAgCu. Vyznačuje se dobrou smáčivostí, vysokou mechanickou pevností a odolností vůči tepelným cyklům. Bezolovnatá alternativa SnPb pájek. Slitina splňuje požadavky směrnice RoHS.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Ag obsah: 3,6 – 4%
Cu obsah: 0,5 – 0,9%
Sn obsah: zbytek
Teplota tavení (liquidus/solidus): 217°C
Hustota: 7,5 g/cm³
Elektrická vodivost: 7,5 Ω mm²

Doporučená pracovní teplota: 260-320°C

Dodávané tvary a balení:

Drát: Ø0,5 – 6mm

100 g	<i>cívka Ø 39 mm</i>
250 g	<i>cívka Ø 50 mm</i>
500 g	<i>cívka Ø 63 mm</i>
1000 g	<i>cívka Ø 70 mm</i>
2000 g	<i>cívka Ø 100 mm</i>
4000 g	<i>cívka Ø 125 mm</i>
6000 g	<i>cívka Ø 160 mm</i>

Tavidla :

Tavidlo MTL461 – 1.1.3.B dle EN 29454-1 / DIN **F-SW-32** / **ROL0** by IEC (Obsah tavidla 2,5% ±0,2%)

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 2 roky od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.